

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2025 年 2 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年度公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。为实现在 2026 年持续巩固现有发展成果，并推动业绩与治理水平进一步提升，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案旨在复盘 2025 年相关举措的实施成效，同时规划下一阶段关键行动，聚焦运营效能提升、市场竞争优势强化、投资者权益保障及资本市场品牌形象塑造等方面，确保公司高质量可持续发展。具体情况如下：

一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力

1、聚焦主业，专注专业价值创造，驱动业绩实现可持续增长

过去一年中，公司始终坚持“技术差异化、产品平台化、客户全球化”战略。公司利用技术差异化优势，提升产品的市场竞争力，成功把握市场机遇；凭借深入推进产品平台化，日益完善自身产品矩阵，满足了客户的多样化需求，市场认可度不断提高；通过稳步推进客户全球化，持续加大市场开拓力度，成功扩大客户群体。得益于全球半导体市场的活跃、公司管理层对既定战略的坚持以及全体员工的共同努力，公司经营业绩在 2025 年继续保持增长，全年共实现营业收入 678,617.02 万元，同比增长 20.80%，实现归属于上市公司股东净利润 139,592.95 万元，同比增长 21.05%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 121,990.80 万元，同比增长 10.02%。

2、持续深耕核心业务，积极拓展市场边界

根据中银证券专题报告的历年累计数据统计显示，公司清洗设备的国内市占率为 23%；Gartner 2025 年数据显示，公司清洗设备的国际市占率为 8.0%，电镀设备的国际市占率为 8.2%，全球排名分别为第四和第三。

目前，公司自主研发的差异化核心设备已获得多家客户的关注与认可，2026 年公司已经有产品进入新加坡市场，2025 年亦有四台设备进入美国市场。同时公司也在积极推进韩国、中国台湾等市场的扩张。公司正积极推进 Ultra ECP ap-p 面板级电镀设备、Ultra C vac-p 面板级负压清洗设备和 Ultra C bev-p 面板级边缘刻蚀设备等三款面板级先进封装的新产品在中国台湾市场的应用及拓展，目前已取得一定成效。拥有上述三款面板级先进封装的新设备作为公司在中国台湾市场的“桥头堡”，2026 年公司晶圆级封装设备亦有信心在中国台湾打开市场。

2026 年，公司将进一步强化市场开拓的资源保障、提升执行速度，通过加速释放差异化产品的市场潜力，支撑营收持续攀升，并与全球半导体产业协同发展。

3、坚持差异化创新，加强研发投入与成果转化

半导体专用设备企业的研发能力是其核心竞争力的关键。随着半导体技术的快速发展，半导体工艺制程不断缩小，半导体芯片结构越来越复杂，制造工艺的难度也不断增加，对半导体设备的功能和性能要求不断提高。公司对技术研发高度重视，并持续保持高强度的研发投入，以实现半导体设备的持续迭代研发，适应新的市场需求。公司 2025 年度研发投入为 125,471.34 万元，同比增加 49.64%，占公司 2025 年度营业收入的比例为 18.49%。同时，公司非常重视技术人才建设，通过市场招聘、内部培养等方式，不断扩充自身的技术人才队伍，截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 1,228 人，占公司员工总数的 49.42%，较上年末增长了 2.92%。此外，公司同样重视技术成果转化，2025 年公司及其控股子公司共申请专利 447 项，比上年增长了 43.73%，截至 2025 年 12 月 31 日累计申请专利 2,087 项，比上年末增长了 36.76%。2025 年，公司及子公司共获得专利权 57 项，截至 2025 年末公司及子公司拥有已获授予专利权 533 项（其中发明专利共计 528 项），比上年末增长了 13.40%，其中境内授权专利 212 项，境外授权专利 321 项。

在技术成果应用和“落地”方面，2025 年 3 月的 SEMICON CHINA 2025 展

会上,公司作为技术差异化高端半导体设备供应商亮相了 Tahoe-SPM 清洗设备、单片高温硫酸清洗设备、单片清洗及超临界二氧化碳干燥设备、背面清洗设备、边缘湿法刻蚀设备、面板级先进封装电镀设备、原子层沉积炉管设备、PECVD 设备、Track 设备等产品,为行业内的客户带来了更优质、更领先的半导体专用设备及工艺解决方案。2025 年 6 月,公司 ECP 设备 1500 电镀腔顺利交付,此次交付的 ECP 设备 1500 电镀腔,在稳定性、精度和效率等方面均达到了行业领先水平,能够满足客户在半导体制造过程中的多样化需求。2025 年 7 月,公司完成对 Ultra C wb 湿法清洗设备的重大升级,提升其蚀刻均匀性、颗粒去除性能以及扩展其工艺能力等。2025 年 9 月公司推出首款 KrF 工艺前道涂胶显影设备 Ultra Lith KrF,旨在支持半导体前端制造,并扩充公司光刻产品系列,此次推出的 KrF 系统可均匀涂布次埃级涂层,具备先进温控技术以及与 ASML 光刻机匹配的关键尺寸(CD)精度,为 KrF 型号的设计优化奠定坚实基础,同月首台设备系统已交付于中国头部逻辑晶圆厂客户。2025 年 11 月,公司完成面板级先进封装电镀设备 Ultra ECP ap-p 和先进光刻胶固化设备 Ultra Lith BK (Baker) 首台设备的交付。

除此之外,2025 年 3 月,公司自主研发的面板级水平电镀设备,斩获由美国 3D InCites 协会颁发的“Technology Enablement Award”奖项;2025 年 9 月,公司单片槽式组合清洗设备(Ultra C Tahoe)荣获中国国际工业博览会评奖部主办、上海市集成电路行业协会共同组织的“2025 中国国际工业博览会集成电路创新成果奖”;2025 年 11 月,公司 Ultra C vac-p 助焊剂清洗设备荣获《Global SMT & Packaging》颁发的全球清洁设备领域技术大奖;2025 年 12 月,公司接连荣获“2025 上海硬核科技企业 TOP100 榜单”中的知识产权榜 TOP50 以及公司主导的《三维存储芯片湿法刻蚀关键技术及装备》项目,荣获“2025 年度上海产学研合作优秀项目一等奖”。该项目突破了三维存储芯片制造中的湿法刻蚀技术瓶颈,是产学研深度融合、技术成果高效转化的成功典范。

2025 年,公司全面践行“技术差异化”战略,从研发投入持续加码、技术人才体系构建到科技成果高效转化,均体现了对这一核心战略的坚守。基于该战略的创新实践已取得显著成效——搭载自主技术的系列新型设备成功推向市场,并完成向多家行业知名客户的交付,相关成果亦在国内外权威评选中屡获殊荣,充

分印证了公司的技术实力与创新价值。展望未来，公司将继续坚持差异化创新路径，进一步夯实研发投入机制与成果转化体系，持续强化基础研发能力。通过紧密围绕市场需求，开展对新工艺、新技术的前瞻性布局，推动产品与技术迭代升级，构建“研发—产业—市场”良性循环的发展生态。在此基础上，2026年公司计划将研发投入占营业收入的比例维持在14%-19%之间，以持续赋能技术创新与可持续发展。

4、圆满完成再融资事项，为持续科技创新奠定基础

公司于2024年11月11日收到上海证券交易所出具的《关于受理盛美半导体设备（上海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，2025年6月6日，公司向特定对象发行股票事项经上海证券交易所审核通过。通过公司及各中介机构的共同努力，公司于2025年6月获得了由中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1338号《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，并于9月完成A股竞价定增发行，募集资金总额44.82亿元，发行价格116.11元/股，发行数量3,860.13万股，系近三年A股半导体设备行业最大规模竞价定增（所属行业根据Wind行业名称（2024）统计）。

本次再融资所募集资金的注入及其在主营业务领域的精准投放，有利于显著提升公司整体科技创新水平，系统强化研发能力与核心技术优势，从而为公司持续保持在半导体专用设备领域的科创实力与行业领先地位，奠定坚实的资源与战略支撑。

二、进一步加快、加强对募投项目的推进、管理，巩固提升科技创新成果

1、2021年首次公开发行股票募投项目

2021年11月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币368,523.90万元。截至2025年12月31日，公司IPO募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入金额	投入进度
----	------	-----------	--------	------

1	盛美半导体设备研发与制造中心	144,500.00	128,867.17	89.18%
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	45,000.00	45,458.74	101.02%
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	100.00%
4	高端半导体设备拓展研发项目	73,087.15	74,434.75	101.84%
5	盛美韩国半导体设备研发与制造中心	-	-	0.00%
合计		327,587.15	313,760.65	95.78%

注：1、上述募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入；

2、“盛美半导体设备研发与制造中心”项目尚存在部分需支付已签订合同但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项。

公司为了更好地维护自身及股东的利益，规避因全球营商环境变化带来的风险；同时，为加快“盛美半导体设备研发与制造中心”项目的整体投产进度，进一步提高募集资金的使用效率，保障该项目可按期完工；公司经过审慎考虑后分别于2025年1月、2月召开董事会以及股东大会，决议对“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目进行终止并将拟投入的募集资金24,500.00万元变更投入至“盛美半导体设备研发与制造中心”项目。

2025年6月28日公司披露《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》，公司首次公开发行股票募投项目“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”，均已完成投入或达到预定可使用状态，并完成结项。

2、2024年度向特定对象发行A股股票募投项目

2025年9月，公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额为人民币448,200.00万元。截至2025年12月31日，公司2024年度向特定对象发行股票募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入金额	投入进度
1	研发和工艺测试平台建设	92,234.85	7,123.02	7.72%
2	高端半导体设备迭代研发项目	220,848.66	11,180.25	5.06%
3	补充流动资金	130,418.06	95,630.92	73.33%

合计	443,501.57	113,934.18	25.69%
----	------------	------------	--------

2026年，公司将积极推进再融资募投项目，全力加强募投项目全流程管理，在实施过程中严格遵守募集资金监管要求，坚持专款专用、审慎规划，确保资金使用规范、高效。通过系统化推进项目建设，保障各环节按计划落实，力促募投项目早日投产达效，以此强化公司主营业务竞争力，切实提升公司整体盈利能力和可持续发展水平。

2025年，随着公司首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态，相关投资已转化为稳固的市场竞争力和可持续的创新动能。在此推动下，公司营业收入从2021年的162,086.91万元显著提升至2025年的678,617.02万元，年均复合增长率达43.04%；净利润亦由2021年的26,624.82万元增长至2025年的139,592.95万元，年均复合增长率达51.32%，核心财务指标持续向好，反映出募投项目对公司经营质量的有效提升。2026年，随着公司向特定对象发行A股股票募集资金的到位与投入，公司将进一步完善研发体系、拓展技术布局，推动产品结构优化与产业链协同升级。预计再融资将为公司带来长足的研发能力提升与经营规模扩张，进一步巩固行业地位，增强持续盈利能力，为实现中长期战略目标奠定坚实基础。

三、优化运营管理，提高经营质量与效率

2025年，公司在持续提升经营质量与运营效率的基础上，将始终以产品质量、技术水平和客户服务为核心立足点，深入贯彻“技术差异化、产品平台化、客户全球化”三大战略导向。通过不断优化现有设备性能、深化产品线延伸研发，依托长期技术积累形成的竞争优势及持续高强度的研发投入，公司致力于实现技术领先与市场响应能力的双向提升。在此基础上，公司将通过精细化成本管控、产品结构优化及高附加值业务拓展，全力将2026年全年平均毛利率稳定在42%至48%的区间内，推动盈利质量与经营稳健性同步增强。

1、进一步优化存货管理

公司通过持续优化存货管理体系，完善全流程库存管控机制，包括设定科学

库存警戒线、强化库存、生产与采购环节的协同效能，有效控制存货规模并提升资源周转效率。2025 年度，公司存货周转率为 0.7545，依旧维持在较高水平；2026 年，公司将继续深化存货精细化管理，进一步推动整体运营质量与经营效率的持续提升。

2、保持盈利质量，维持收入增长

未来，公司将继续坚持差异化竞争战略，系统推进现有设备性能优化与产品线延伸开发，持续加大研发投入。聚焦清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、前道涂胶显影 Track 设备、等离子体增强化学气相沉积 PECVD 设备、无应力抛光设备、后道晶圆级先进封装工艺设备、面板级先进封装设备以及硅材料衬底制造工艺设备等产品系列，公司将深入开展新产品研发与迭代升级，加速技术成果的产业化转化。

通过持续拓展新客户、开拓新市场，公司旨在进一步提升半导体设备领域的市场占有率，巩固行业竞争地位。在此基础上，公司将着力提升盈利质量，保障营业收入的可持续增长，实现规模与效益的协同发展。

3、完善人才激励措施

公司为建立健全长效激励机制，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，充分调动员工的积极性和创造性，以进一步吸引和留住优秀人才。2025 年 3 月，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的首次授予部分第一个归属期的股份登记工作；2025 年 11 月，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的预留授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。该计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理（业务）骨干、中层管理（业务）人员以及优秀基层技术（业务）员工。首次授予部分第一个归属期归属人数总计 466 人，认购股票数量 2,550,435 股，授予价格 49.15 元/股；预留授予部分第一个归属期第一批归属人数总计 174 人，认购股票数量 272,275 股，授予价格 48.50 元/股（因公司实施 2024 年度权益分派，授予价格于 2025 年 8 月调整为 48.50 元/股）。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

2025年，公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续优化公司治理结构，保障股东、董事、高级管理人员和其他利益相关者的合法权益，提升公司运营效率和价值创造能力，促进公司可持续发展。

2025年公司召开5次股东会，审议19项议案，聘请专业律师进行审核，出具法律意见书，以确保股东会的规范运作和全体股东的知情权、参与权、表决权和监督权；董事会召开11次会议，审议76项议案。公司全体董事依法履行职责，维护公司和中小股东的利益。董事会新增设立董事会ESG委员会并同步制定《ESG委员会工作规则》，各专门委员会在报告期内按照规章制度正常运作。

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》。公司按照新《公司法》及证监会配套制度规则等规定，取消公司监事会，将原监事会职责交由董事会审计委员会行使。同时，为配合取消监事会后的公司治理，公司配套完成了《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《独立董事专门会议工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等23项公司治理制度的修订或制定，进一步完善法人治理和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二次会议，于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公司根据《上市公司治理准则》等有关规定制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并完成了《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》等5项公司治理制度的修订，全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升了公司治理水平。

2025年，公司持续推进ESG理念与经营管理的深度融合，公司董事会对ESG治理架构进行重要优化，在董事会下设ESG委员会，进一步明确ESG相关事项在战略决策、监督管理与执行层面的职责分工。同时，公司依据最新监管要求及

国际可持续信息披露准则，系统开展双重重要性分析工作。通过问卷调研、访谈及内外部评估相结合的方式，广泛征询各关键利益相关方的意见。2025年，公司相继被纳入多项 ESG 主题指数覆盖范围，相关指数涵盖境内外具有代表性的 ESG 评价体系，体现了公司在可持续投资领域的可见度和市场关注度。评级方面，公司 MSCI ESG Rating 达到“BBB”级，中证 ESG 评级达到“AA”级，中诚信绿金 ESG 评级达到“A+”级，Wind ESG 评级达到“A”级。

2026年公司将根据新《公司法》等相关法律、法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修改、完善，包括如下措施：

1、继续完善公司相关内控制度

公司构建了较为完善的内部控制和审计整改机制，并设定外部审计整改率达100%的目标，推动治理效能持续提升。公司将持续结合经营实际与法律法规更新，动态完善内部控制制度体系，确保内控制度与时俱进，构建起既符合监管要求又适配公司发展实际的规范化内控机制。同时，公司董事、高级管理人员将积极参与监管部门组织的各项培训，系统学习证券市场相关法律法规与业务知识，持续增强合规意识与履职能力，推动公司治理与运作持续规范、稳健发展。

2、继续为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制

公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用。

3.加强 ESG 工作管理，持续提升 ESG 评级成果，创造长期可持续价值

ESG 管理不仅是合规要求，更是支撑公司技术创新能力、市场竞争力和长期价值创造的重要组成部分。2026年，公司将持续关注中国国内外监管趋势和利益相关方期望，推动 ESG 理念与公司战略、研发投入和运营管理的进一步融合，不断提升公司在可持续发展方面的前瞻性和执行力，为股东、员工、客户及社会创造长期、稳定和可持续的价值。

五、持续加强投资者沟通交流，提升信息披露透明度

公司持续强化信息披露与投资者沟通，公司在上海证券交易所 2024—2025 年信息披露考核中考评结果为 A，信息披露的规范性和透明度保持在较高水平。公司全年组织投资者交流会 64 场、业绩交流会 4 场、业绩说明会 4 场，投资者提问回复率为 95%。

2025 年 6 月 12 日，公司在临港研发与制造中心成功举办 2025 年投资者开放日活动，当日举行多场投资者交流活动，吸引众多个人投资者、机构投资者与行业分析师现场参与。公司董事长 HUI WANG、总经理王坚、财务负责人 LISA FENG、副总经理陈福平、董事会秘书罗明珠等管理层出席活动，并与投资者深入交流。活动当天安排了实地参观、专题讲解与互动问答等多个环节，全面展示公司在产品布局、技术创新、全球化战略等方面的最新进展。此次活动不仅增强了投资者对公司的了解，也体现了公司持续推进高质量投资者关系管理的坚定态度。

此外，公司亦在官网设置投资者关系专栏以及“盛美上海”公众号平台，方便投资者及时把握公司的最新信息。2025 年期间公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，信息披露真实、准确、完整和及时，并确保公司信息披露的高透明度。

2026 年公司将继续完善投资者的管理工作，强化与投资者的互动沟通，拓宽与投资者的交流渠道，依托“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办不少于 8 次投资者线上交流会，让投资者全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任与支持，打造高效透明的沟通平台。公司将进一步利用公司官网以及“盛美上海”公众号平台，让投资者通过多种渠道，更便捷、及时地获取公司相关信息。

六、持续完善投资者回报机制，提升投资价值

2025 年 6 月至 8 月期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交

易方式累计回购公司股份 443,400 股，占公司当时总股本 441,291,188 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 115.49 元/股，最低价为 110.81 元/股，支付的资金总额为人民币 50,012,340.46 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报。2024 年 1 月 26 日，公司制定并披露《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，公司将根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司董事长 HUI WANG 所提议的议案：未来 3 年（2024 年至 2026 年）的现金分红，每年保持在当年归属于上市公司股东净利润的 25%-30% 之间。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2025 年 6 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 438,740,753 股，以剔除已回购股份 0 股后的总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 6.57 元（含税），共计派发现金红利 288,252,674.72 元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2024 年合并报表归属于母公司股东净利润的 25.00%。考虑到 2025 年上半年，公司实施《2023 年限制性股票激励计划》以及股份回购，致参与本次分红的股数发生变化。公司于 2025 年 7 月 3 日进行公告，将公司 2024 年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利 0.65386 元（含税），利润分配总额为 288,252,734.66 元（含税）。

2025 年公司继续秉持“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动。与此同时，公司亦将继续努力践行《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》以及董事长 HUI WANG 于此前的分红提议，统筹好公司的经营状况、业务发展目标以及股东回报，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让投资者共享公司的发展成果，增强投资者价值获得感。

为切实贯彻股东回报战略，公司基于 2025 年度经营业绩及财务状况，拟实施如下 2025 年度利润分配方案：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 480,164,789 股，以剔除已回购股份 443,400 股后的总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 6.233 元（含税），共计派发现金红利 299,010,341.76 元（含税）。本次利润分配现金分红金额占 2025 年合并报表归属于母公司股东净利润的 21.42%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 50,012,340.46 元，现金分红和回购金额合计 349,022,682.22 元（含税），占 2025 年合并报表归属于母公司股东净利润的 25.00%。该利润分配方案尚需提交股东会审议。

七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司严格执行此前制定的行动方案，并取得了一定进展。此后公司将持续评估行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，同时坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强与投资者沟通交流，维护公司良好市场形象。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日